

Lotpaste KPF 01 XL1 für bleihaltige Anwendungen

KETIN
bleihaltige Lotprodukte

Allgemeine Beschreibung

Lotpaste KPF 01 XL1 ist eine no-clean Lotpaste für den Reflowprozeß, sowohl unter Schutzgas als auch unter Atmosphäre. Sie zeichnet sich durch ein großes Prozessfenster aus, kann bis zu 8 Stunden auf der Schablone verbleiben, und verträgt eine Druckpause bis zu 60 Minuten ohne die Druckeigenschaften bis zu einem 0,5mm pitch Abstand zu verschlechtern. Die Paste ist eine Neuentwicklung speziell für OSP-Finish, zeigt aber auch auf chemisch Zinn und Nickel Gold sehr gute Lötresultate. Die Rückstände der KPF 01 XL1 sind leicht gelblich und enthalten keinerlei „solder balls“.

- Sehr gute Benetzung auf den meisten Oberflächen
- Hohe Druckgeschwindigkeiten bis zu 150 mm/sec
- Sehr gute Aktivität auch auf OSP Oberflächen
- Standzeit auf der Schablone über 8 Stunden
- Stabile Klebrigkeit bis 24 Stunden
- Ausgezeichnete Druckeigenschaften bis 0,4 mm pitch mit Klasse 3 Pulver
- Sehr gute Slump Eigenschaften
- Sehr gut geeignet für BGA und µBGA

Physikalische Eigenschaften

- Daten für Sn62Pb36Ag2 90% Metall, Klasse 3, 25-45 micron
- Viskosität: Brookfield: 800 kCp
IPC-TM-650 2.4.34 +2
- Klebrigkeit: 18-24 Stunden
- Konturenstabilität (Slump): Bestanden
J-STD-005, IPC-TM-650, Method 2.4.35
EN 61190-1-2:4.6
- Solder Ball Test: Bestanden
J-STD-005, IPC-TM-650, Method 2.4.43
EN 61190-1-2:4.7

TECHNISCHE INFORMATION

Stand: 30.07.2012_V.2.0

Zuverlässigkeitsuntersuchungen

- Daten für Sn62Pb36Ag2 90% Metall, Klasse 3, 25-45 micron
 - Copper Mirror Korrosion: L
J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.3.3
 - Silver Chromate: Bestanden
J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.3.33
 - Fluoride by Spot Test: Bestanden
J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.3.35.1
 - Isolationswiderstand
J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.3.35.2
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| KPF 01 XL1 nach 24 Stunden: | $9,6 \times 10^8$ |
| KPF 01 XL1 nach 96 Stunden: | $1,0 \times 10^9$ |
| KPF 01 XL1 nach 168 Stunden: | $1,0 \times 10^9$ |
| Blank nach 24 Stunden | $1,1 \times 10^{10}$ |
| Blank nach 96 Stunden | $1,2 \times 10^{10}$ |
| Blank nach 168 Stunden | $1,2 \times 10^{10}$ |

Klassifizierung

Klassifiziert nach: DIN EN 29454 als Typ 1.1.2.C und nach IEC 61190-1-1 als ROL1.

Reinigung

Die Baugruppe muss nicht gereinigt werden, die Rückstände können auf der Platine verbleiben. Im Falle einer Reinigung empfehlen wir die handelsüblichen Produkte.

Verpackung

Dosen: 250 g und 500 g Kassetten: DEK PRO-FLOW™ Kassetten 750g
Kartuschen: 600 g und 1200 g (SEMCO)

Lagerung und Lagerfähigkeit

Dosen: maximal sechs Monate, im geschlossenen Gebinde bei gekühlter Lagerung von 6-16°C.
Kartuschen: maximal 3 Monate bei gekühlter Lagerung von 6-16°C.
Lagerung bei bis zu 20 °C ist für mehrere Wochen möglich. Bei längerer Lagerzeit wird eine gekühlte Lagerung bei 2-7 °C empfohlen. Vor dem Öffnen der Gebinde sollte das Material Umgebungstemperatur erreicht haben.

TECHNISCHE INFORMATION

Stand: 30.07.2012_V.2.0

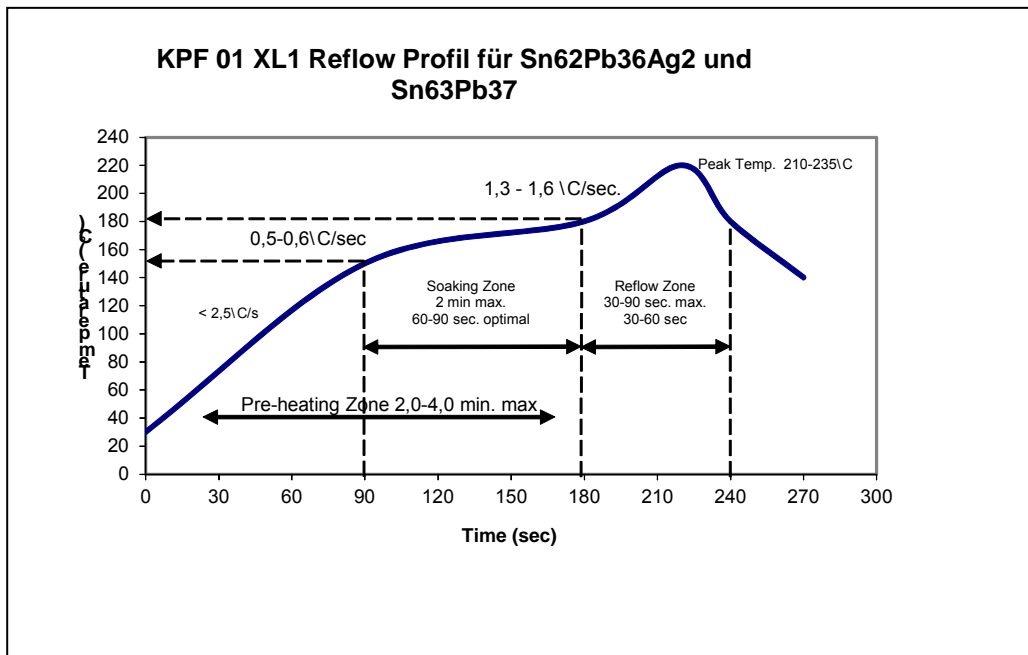
Druckparameter

- Raket: Edelstahl
- Raket Geschwindigkeit: 25 - bis 150mm /sec möglich
- Schablonen Material: Edelstahl,
- Temperatur / Feuchte: Optimaler Bereich 35-65% Feuchte bei 21-25 °C

Legierungen

Mögliche Legierungen sind: Sn63Pb37; Sn62Pb36Ag2;

Reflow Profil:



Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit oder Gewährleistung kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch bezüglich der Schutzrechte Dritter, nicht übernommen werden.